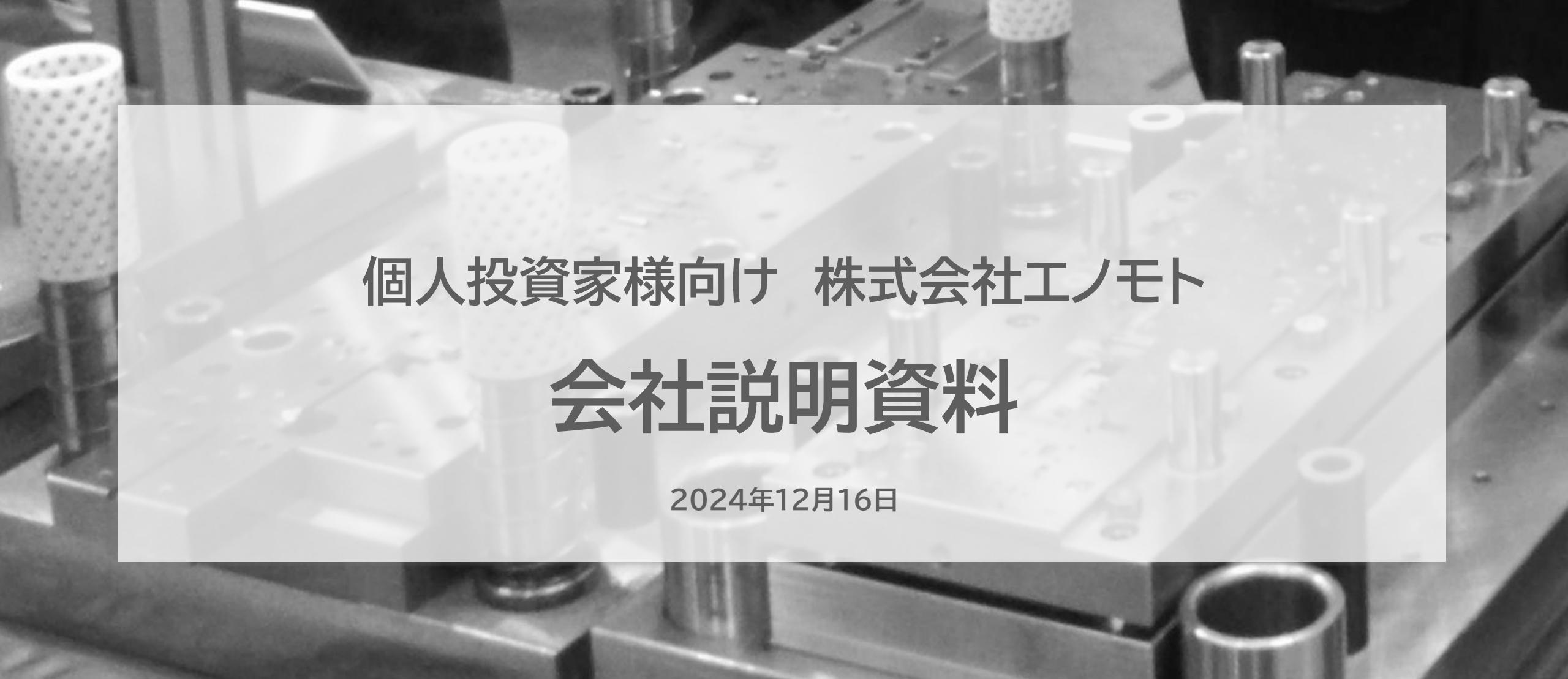




個人投資家様向け 株式会社エノモト 会社説明資料

2024年12月16日

ENOMOTO Co.,Ltd.

東証プライム 証券コード:6928

(1) 会社概要	P. 3
(2) 2025年3月期第2四半期決算・通期業績予想	P.16
(3) 中期経営計画	P.22
(4) 株主還元・株価推移について	P.27
(5) SDGsへの取り組み	P.31
参考資料	P.36

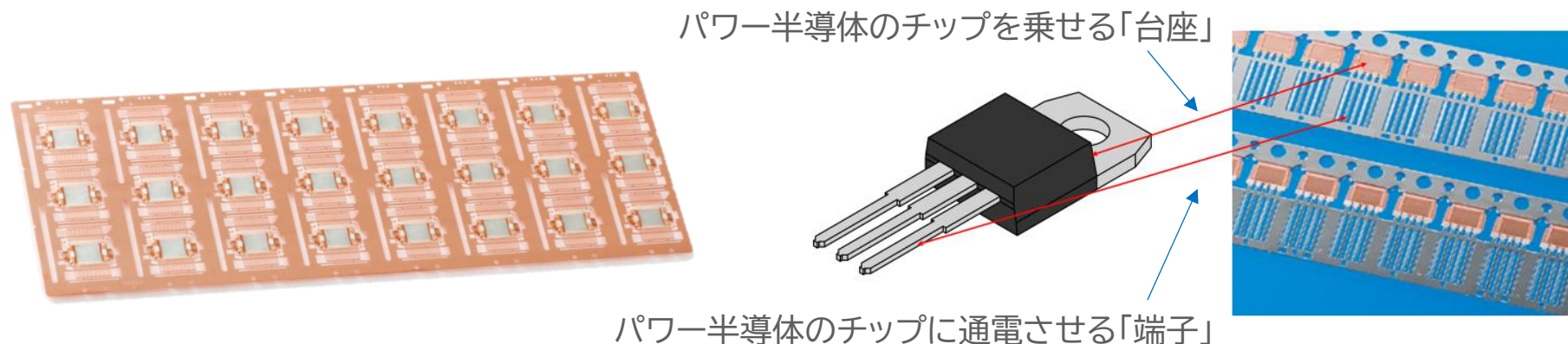
(1)会社概要



社名	株式会社 エノモト ENOMOTO Co.,Ltd.
設立	1967年4月(創業 1962年7月)
代表取締役社長	白鳥 誉
本社所在地	山梨県上野原市上野原8154-19 TEL : 0554-62-5111
生産拠点	本社工場:山梨県甲州市／山梨県上野原市 津軽工場:青森県五所川原市 岩手工場:岩手県上閉伊郡大槌町 技術部 :山梨県甲州市 エノモトフィリピン:フィリピン カビテ州 (連結子会社) 中山エノモト:中国 広東省 中山市 (連結子会社)
資本金	4,749百万円
従業員(正社員)数 (2024年3月31日 現在)	国内 :524人 ※国内従業員 平均年齢 40.7歳 フィリピン:466人 中国 :264人
事業内容	(1)各種半導体用部品(リードフレーム)及びコネクタ用部品製造、販売 (2)プレス金型及びインサート成形金型の開発、設計、製作

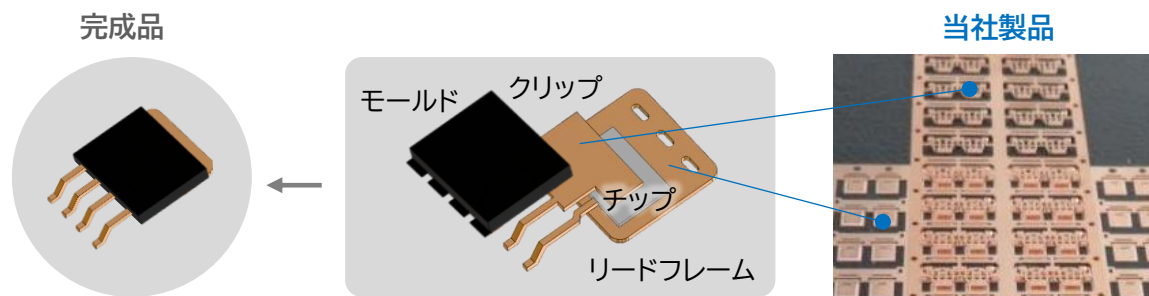


従来型のパワー半導体用リードフレーム



クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム

- 車載ECU*1やデータセンタ向けパワー半導体の高電圧・大電流化に伴い、従来のリードフレームを上回る高信頼性と省スペース化の要求から接触面積が大きく、通電容量の高いクリップボンディングの注目が高まる



- クリップとリードフレームでチップを挟み込むため大きな面で接続でき、電気特性と熱特性が高まる
- 平坦度(位置精度)が低いと非接触部分ができパワー半導体の電流量が低下

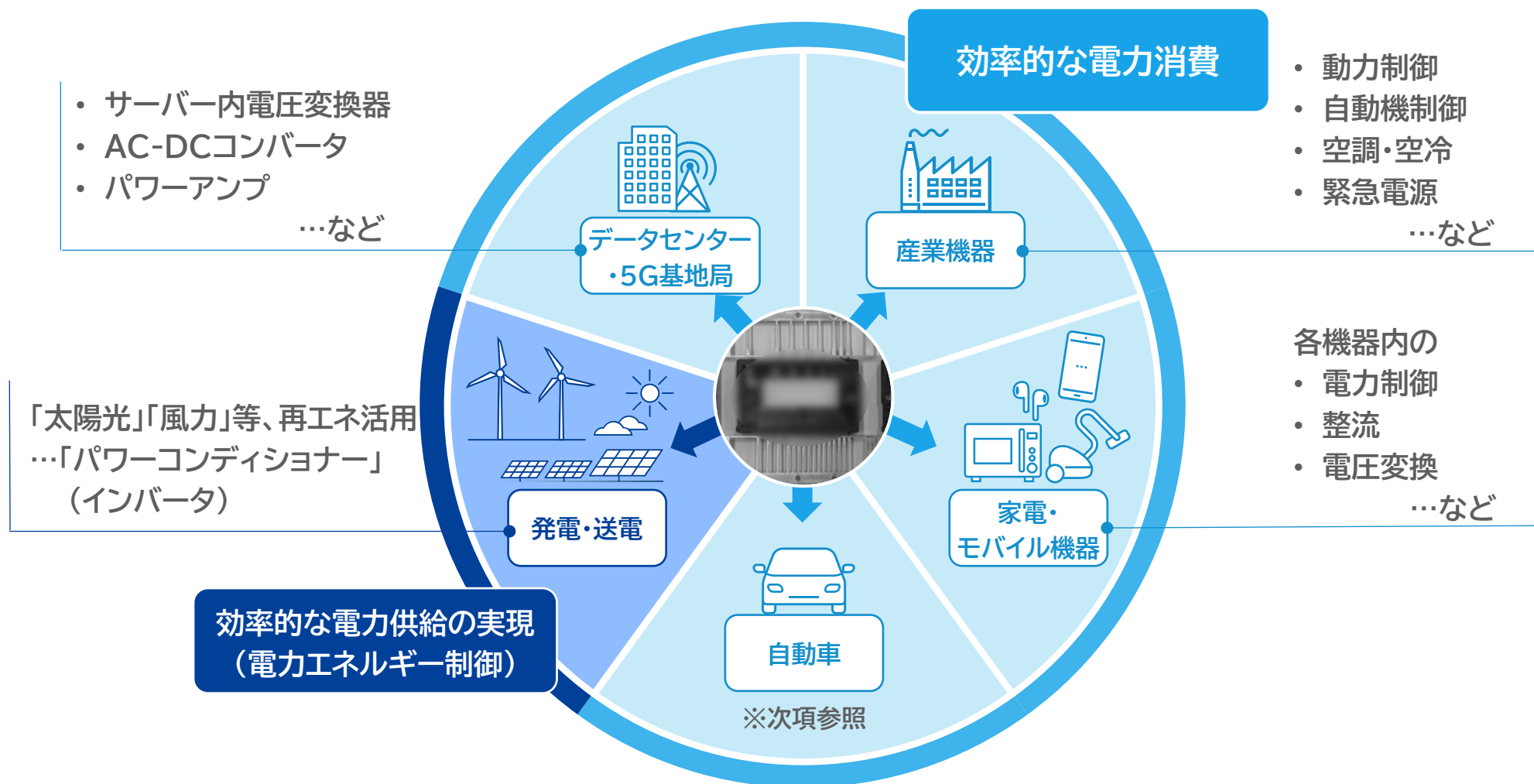
高耐熱性

長寿命化

平坦度(位置精度)・清浄度の要求が高く、高い付加価値率、他社に先駆けて本格量産開始

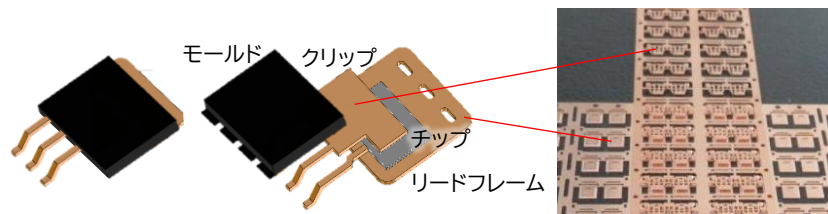
*1 ECU Electronic Control Unit

- xEVやデータセンター向けなどに高効率な電力供給を支える高機能パワー半導体に、環境側面からも注目が集まる
- SiC・GaNパワー半導体を使うことで、高電圧・大電流化に加え低損失を実現し、高出力・省エネに寄与



* SiCはSilicon Carbide(炭化ケイ素)、GaNはGallium Nitride(窒化ガリウム)の略

クリップボンディング方式パワー半導体用リードフレーム



汎用パワー半導体用
リードフレーム



IGBT用
リードフレーム



パワーIC用
リードフレーム



パワーデバイス適用製品

計**40**品種以上

パワートレイン制御

- モーター制御
- バッテリー
- インバータ
- レギュレータ
- オルタネータ
- トランスミッション制御
- ラジエーターファン制御



車両制御

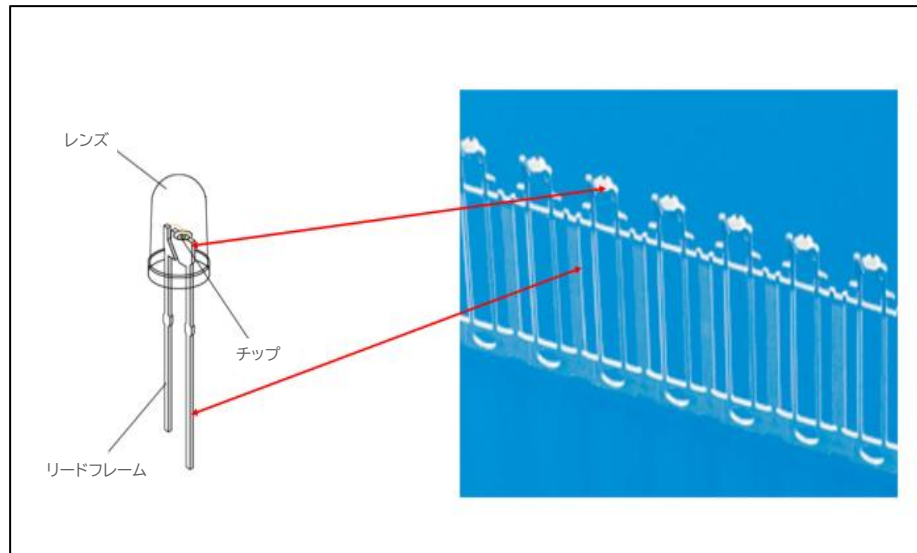
- ステアリング制御
- クルーズ制御

ボディ制御

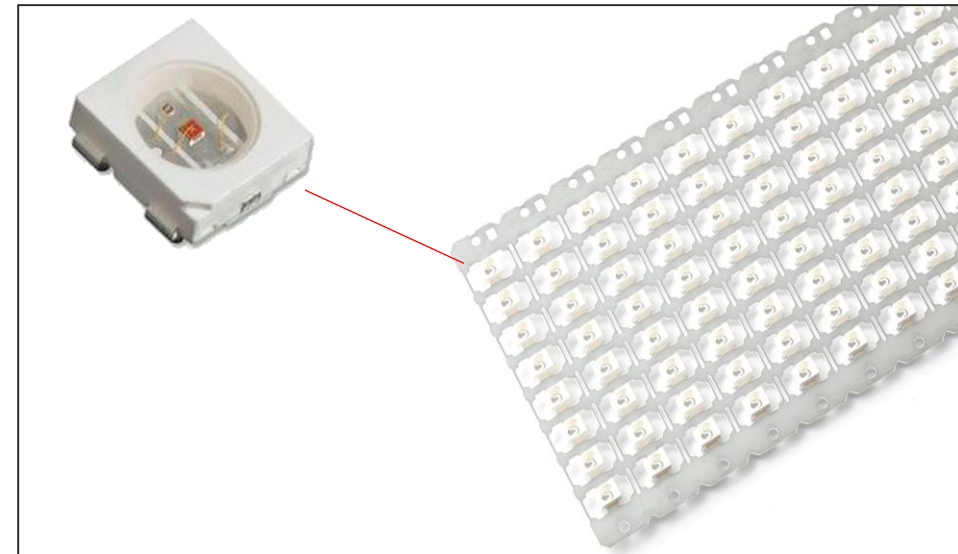
- パワーウィンドウ
- オートマチックドアロック
- 電動シート
- ライト制御
- ナビコン
- マイコンエアコン

- 当社の販売先(LEDメーカー)でチップを乗せて光源となる
- チップを乗せる部分(カップ)の高い形成技術で、より鮮やかな輝きを作る
- 大きく分けて砲弾型と表面実装(SMD)の2種類
- 砲弾型のリードフレームを大量生産できる、国内唯一のメーカー

LED用リードフレーム(砲弾型)



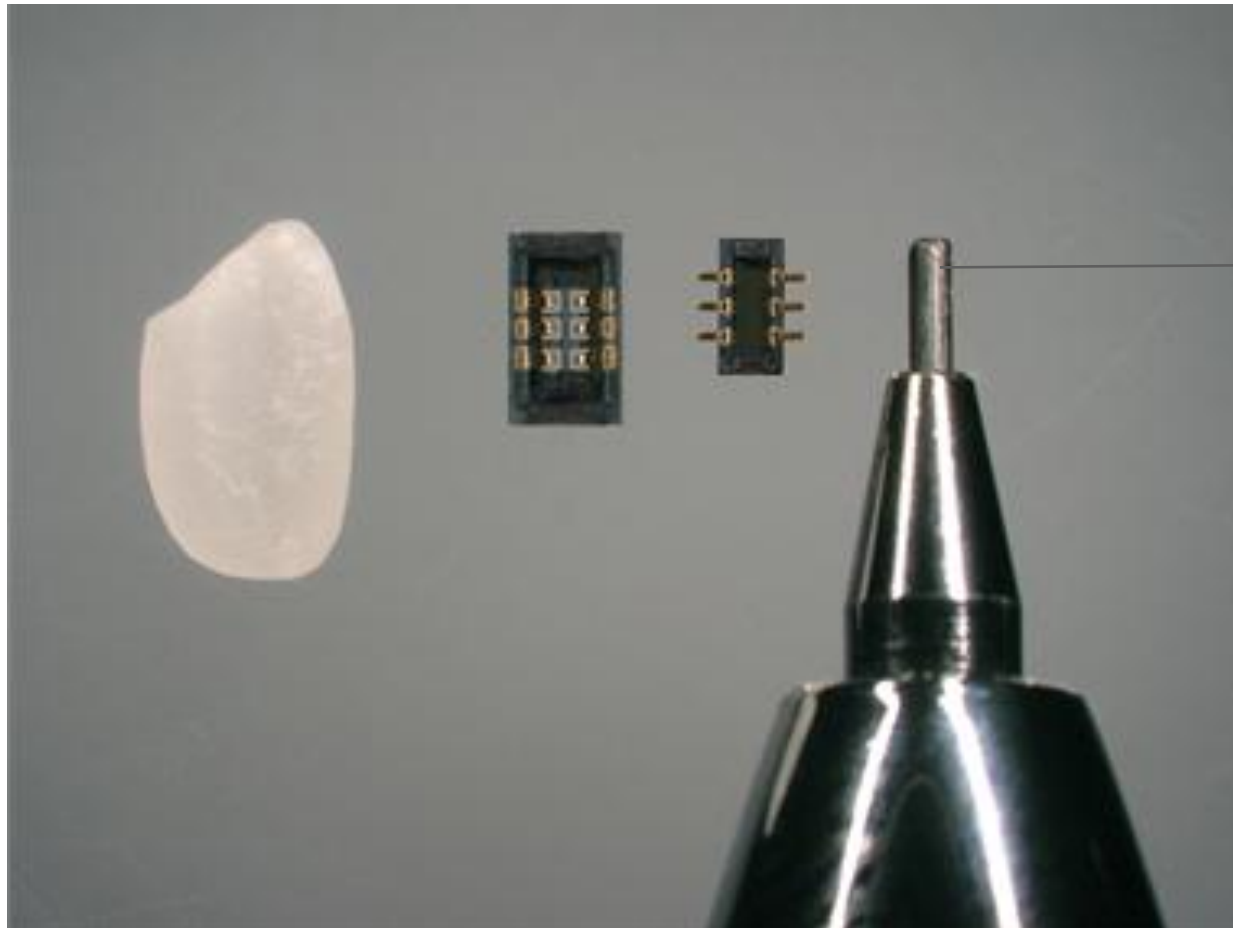
LED用リードフレーム(SMD)



- 世界最高水準の超精密コネクタ部品

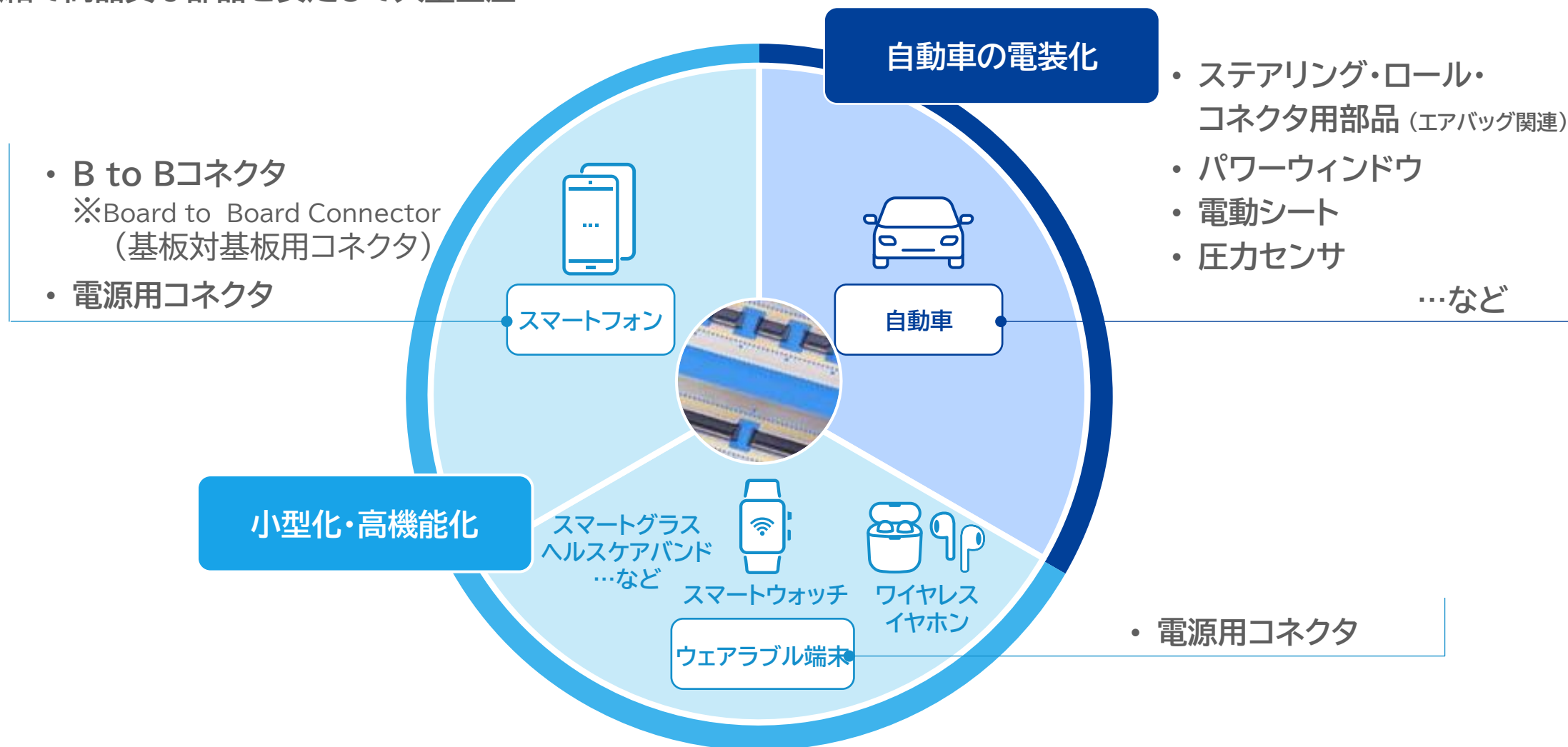
使用先…スマートフォン

ウェアラブルデバイス(スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン等)



シャープペンシル芯
(Φ 0.5mm)

- ・ スマートフォン・ウェアラブル端末向けの極小部品から、自動車向けの特殊で大きな部品まで幅広く対応
- ・ 超微細で高品質な部品を安定して大量生産



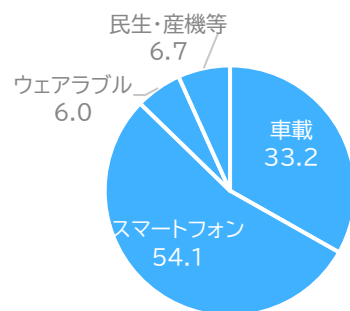
- ・ パワー半導体用リードフレームは車載向けは緩やかな回復基調だが、民生・産機向けの汎用リードフレームが減少
- ・ オプト用リードフレームは大型ディスプレイ向けが減少
- ・ コネクタ用部品は車載向けは回復したが、スマートフォン向けが低迷

その他

売上高 **495**百万円
前同比 $\Delta 25.0\%$
構成比 **2.0%**

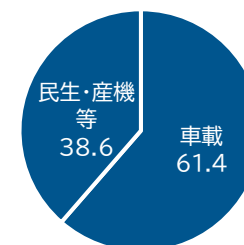
コネクタ用部品

売上高 **10,989**百万円
前同比 $\Delta 14.9\%$
構成比 **43.5%**



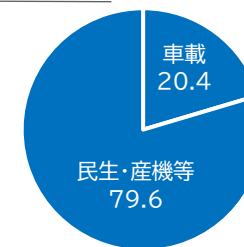
パワー半導体用リードフレーム

売上高 **11,112**百万円
前同比 $\Delta 7.2\%$
構成比 **44.0%**



オプト用リードフレーム

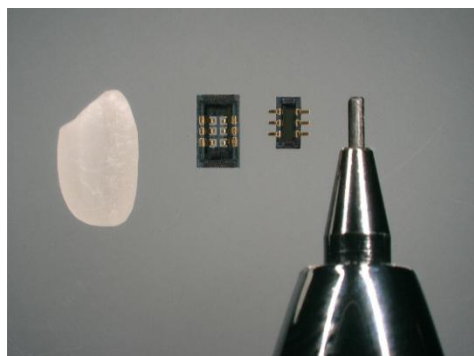
売上高 **2,647**百万円
前同比 $\Delta 28.8\%$
構成比 **10.5%**



売上高
25,244百万円
(2024/3期)

1

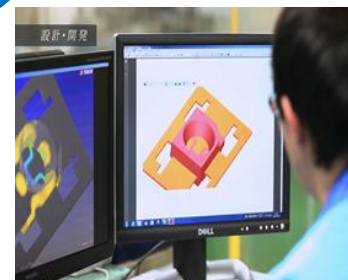
金属と樹脂の複合加工技術力



技術力

2

高品質・大量生産体制を支える
生産技術力



3

海外でも日本品質の生産体制

一貫生産

4

独立系としてのサービスポジション

中国

クリップボンディング
リードフレームで先行



フィリピン

車載向けコネクタ用部品の
主力工場



材料メーカーや
協力会社

幅広い顧客
ニーズ

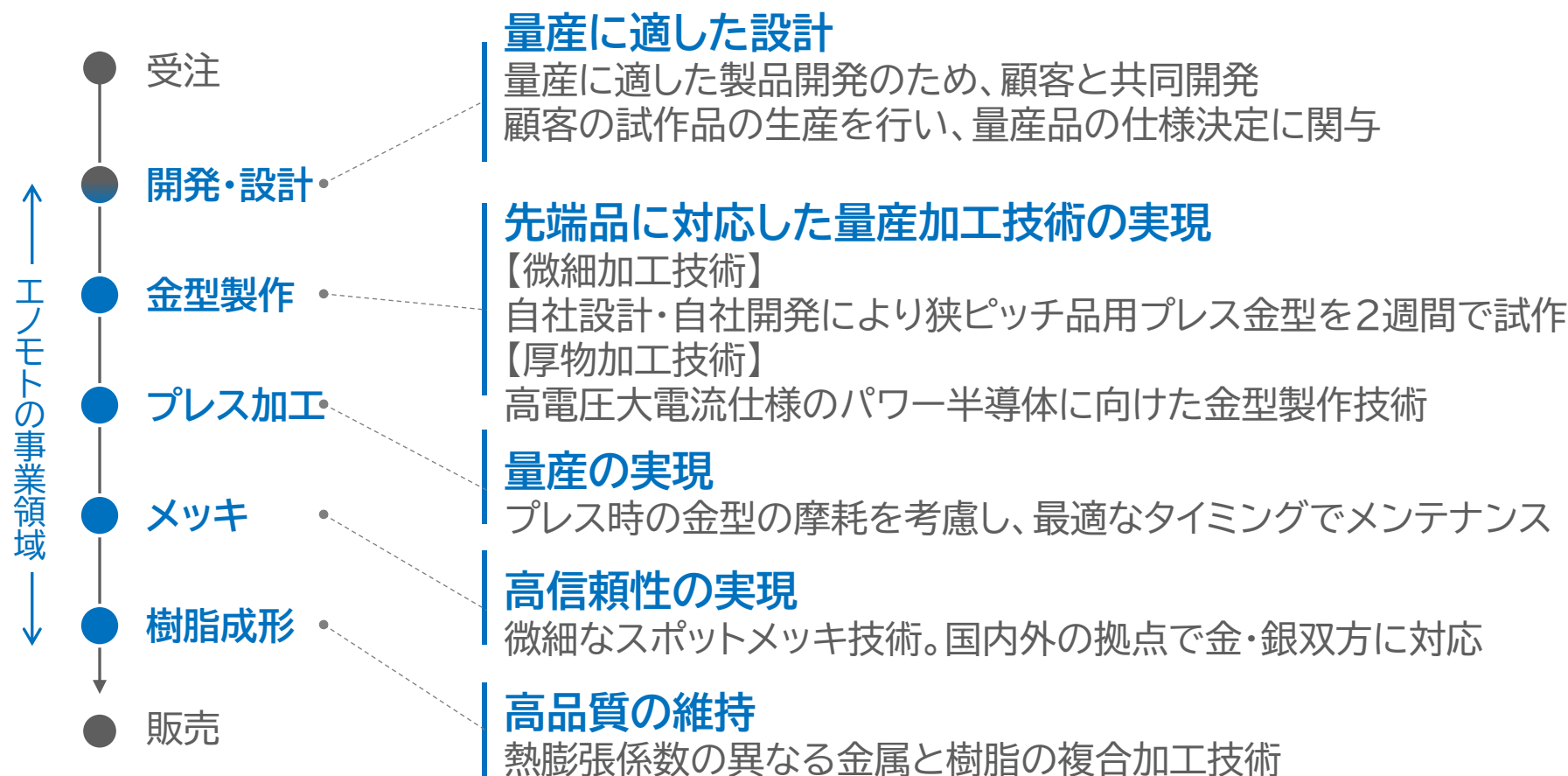
最適な調達

エノモト

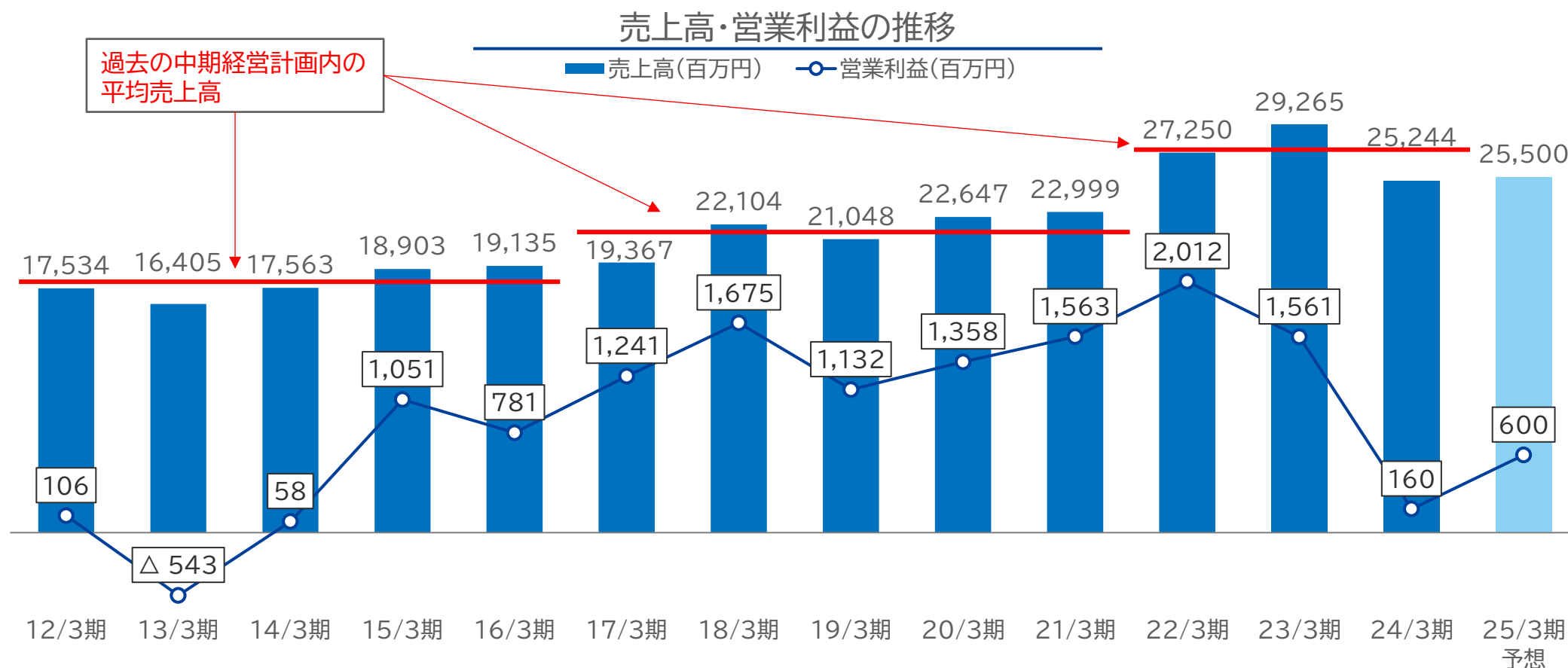
柔軟な対応

特定の資本に縛られない
自由な営業方針

- ・ 強みである金型の設計・開発、プレス加工の技術を活かし、生産に特化
- ・ スマートフォン向けなどのマイクロコネクタ、パワー半導体用リードフレームの精密加工に強み
- ・ クリップボンディングリードフレーム、マイクロコネクタを大量生産できる企業は限られ、当社への受注が増加



- ・ 2021年3月期までの5年間は、マイクロコネクタ等の成長により売上高200億円前後・営業利益も15億円前後に
- ・ ビジョン2030 1st STEPでは、22年3月期に過去最高益を計上したものの、23年3月期4Qからはスマートフォンを中心として民生・産機向けが調整局面に
- ・ 津軽工場新棟など先行投資に伴う償却費の増加もあり24年3月期は大幅減益
- ・ 2nd STEPで1st STEPでの先行投資の刈り取りを狙う



(2)2025年3月期第2四半期決算・ 2025年3月期業績予想



- 上期実績は期初想定線ながら増収増益。オプト向けでハイエンド品の出荷が始まったことや、コネクタ部品のウェアラブル端末向けが回復したものの本格的な回復水準には戻らず
- 増収に伴う稼働率の改善により粗利率も上昇

単位:百万円	2023/3期2Q累計		2024/3期2Q累計(前中間)		2025/3期2Q累計(当中間)		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前同比(%)
売上高	14,650	100.0	13,020	100.0	13,419	100.0	3.1
売上総利益	2,173	14.8	1,364	10.5	1,651	12.3	21.0
販管費	1,234	8.4	1,227	9.4	1,293	9.6	5.4
営業利益	938	6.4	137	1.1	358	2.7	161.1
為替差損益	138	0.9	29	0.2	△56	-	-
経常利益	1,127	7.7	190	1.5	364	2.7	91.6
当期純利益	778	5.3	87	0.7	270	2.0	208.7
1株当たり純利益	116.58円	-	13.10円	-	40.45円	-	
1株当たり中間配当金	30.0円		35.0円		35.0円		

- 第2四半期は前年同期比、1Q比ともに増収増益
- 利益面では、稼働率の上昇やマイクロコネクタなど付加価値の高い製品の増収により増益

単位:百万円	2024/3期					2025/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同比(%)	1Q比(%)
売上高	6,426	6,593	6,169	6,053	25,244	6,506	6,912	+4.8	+6.2
売上総利益	722	642	730	558	2,654	749	902	+40.4	+20.4
販管費	590	637	626	639	2,494	645	648	+1.7	+0.5
営業利益	132	4	103	△80	160	104	253	+5302.5	+143.0
為替差損益	12	16	△41	29	17	5	△61	-	-
経常利益	162	27	89	12	291	135	228	+727.1	+68.3
四半期純利益	96	△9	29	3	121	47	223	-	+373.6

- 売上高は2024年3月期4Qをボトムに回復トレンド
- パワー半導体用リードフレームは車載向けが横ばい、民生・産機向けは調整が続いた
- オプト用リードフレームは大型ディスプレイ向けは低迷が続いたが、ハイエンド品の量産が始まり、全体として底打ち
- コネクタ用部品はスマートフォン向けが減少し車載向けは前期並みだが、ウェアラブル端末向けは新製品向けで増加

単位:百万円	2024/3期					2025/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	前同比 (%)	1Q比 (%)
パワー半導体用 リードフレーム	3,164	2,832	2,516	2,598	11,112	2,662	2,734	△3.5	+2.7
オプト用 リードフレーム	712	662	648	624	2,647	728	742	+12.1	+1.9
コネクタ用部品	2,437	2,970	2,863	2,717	10,989	2,959	3,248	+9.4	+9.8
その他	112	129	141	112	495	156	188	+45.3	+20.4
合計	6,426	6,593	6,169	6,053	25,244	6,506	6,912	+4.8	+6.2

- 上期は増収増益となったが、下期はスマートフォン向けコネクタ部品の季節調整等を見込むことから通期予想は継続
来期は車載向けのコネクタ部品の回復やLEDリードフレームのハイエンド品の生産拡大などのプラス要因があり
2024年3月期をボトムに回復に向かうという中期経営計画の方向は変わらず
- 増収に加えて、付加価値の高い製品の増加により増益を予想

単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	予想	売上比(%)	前期比(%)
売上高	29,265	100.0	25,244	100.0	25,500	100.0	+1.0
売上総利益	4,100	14.0	2,654	10.5	3,150	12.4	+18.7
販管費	2,538	8.7	2,494	9.9	2,550	10.0	+2.2
営業利益	1,561	5.3	160	0.6	600	2.4	+274.4
経常利益	1,805	6.2	291	1.2	600	2.4	+105.5
当期純利益	1,269	4.3	121	0.5	450	1.8	+271.0
1株当たり当期純利益	190.02円	-	18.16円	-	67.64円	-	-
配当金	60.0円	-	70.0円	-	71.0円	-	-

- ・ パワー半導体向けリードフレームは中国向けの民生・産業機器向けが調整継続、下期後半からの底打ちを見込む
- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品の量産が始まり、四半期ごとに増加する見通し
- ・ コネクタ用部品はスマートフォンの新モデル向けで下期から季節調整を見込む
一方で車載向けは顧客の生産再開により堅調

単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	予想	構成比(%)	前期比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	11,112	44.0	10,500	41.2	△5.5
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	2,647	10.5	3,500	13.7	+32.2
コネクタ用部品	12,912	44.1	10,989	43.5	11,000	43.1	+0.1
その他	659	2.3	495	2.0	500	2.0	+1.0
合計	29,265	100.0	25,244	100	25,500	100.0	+1.0

(3) 中期経営計画『ビジョン2030 2nd STEP』 (2025年3月期～2027年3月期)





ビジョン2030

「金型の技術で未来を創る」

より小さく より速く 最先端の技術で 暮らしとビジネスのベストパートナーを目指す

——— ありたい姿 ———

技術

- AI化と無人化による金型技術の進化で常に最先端の市場に向けて高品質な部品をスピーディーに提供し続ける

人材

- 失敗を恐れずチャレンジし多様な人材が活躍できる職場環境づくりを通じてイノベーションを生み新たな企業価値を創造する

環境

- 燃料電池部品の実用化で脱炭素社会の実現に貢献する
- 社会環境におけるリスクと機会を的確にとらえて行動することで信頼される企業であり続ける

- ・ ビジョン2030では、既存製品の需要拡大を見据えつつ、付加価値率の向上を軸とした各種施策で主力製品のマーケット成長を上回る売上・利益成長を図る
- ・ 2nd STEPでは、車載向けリードフレームの生産拡大、ハイエンドLEDの強化、メッキ内製化による付加価値向上を実現する
- ・ 生産面では、精密加工の無人化、スマートファクトリー実現に向け、データの共有化やビッグデータの構築と見える化を推進する



- 金型製作において、1st STEPでは経験値の可視化を実施、2nd STEPでは経験値・職人技を共有し、精密加工の無人化を進める
- 量産工程では、1st STEPで津軽工場・エノモト中山(中国)にメッキラインを増設、複数品目で徐々に量産開始
2nd STEPで量産化による付加価値向上を図る

主な製品の製造工程と収益力・現場力向上施策



- 1st STEPではIoT×新ERPシステムによる「ものづくりの見える化」に着手
- 2nd STEPでは、データの収集と検証を継続して行い、AIの活用に向けた体制整備を推進

1st
STEP

IOT×新ERPシステムによる
シームレスに連携したデータの生成
データのリアルタイム収集の実現

IOT活用



自動倉庫



AGV(無人搬送車)



2nd
STEP

ビッグデータの構築
「見える化」の推進

データの収集・検証

課題の即時把握

経営判断の迅速化



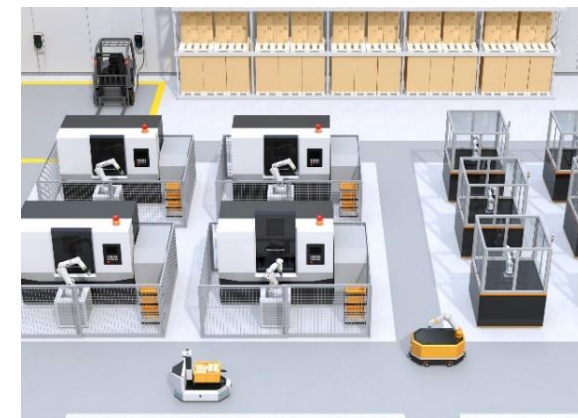
3rd
STEP

ビッグデータとAIの活用

高度なスマートファクトリー
最適化・自動化

AIによる学習・分析

高度な生産計画



(4)株主還元・株価推移について

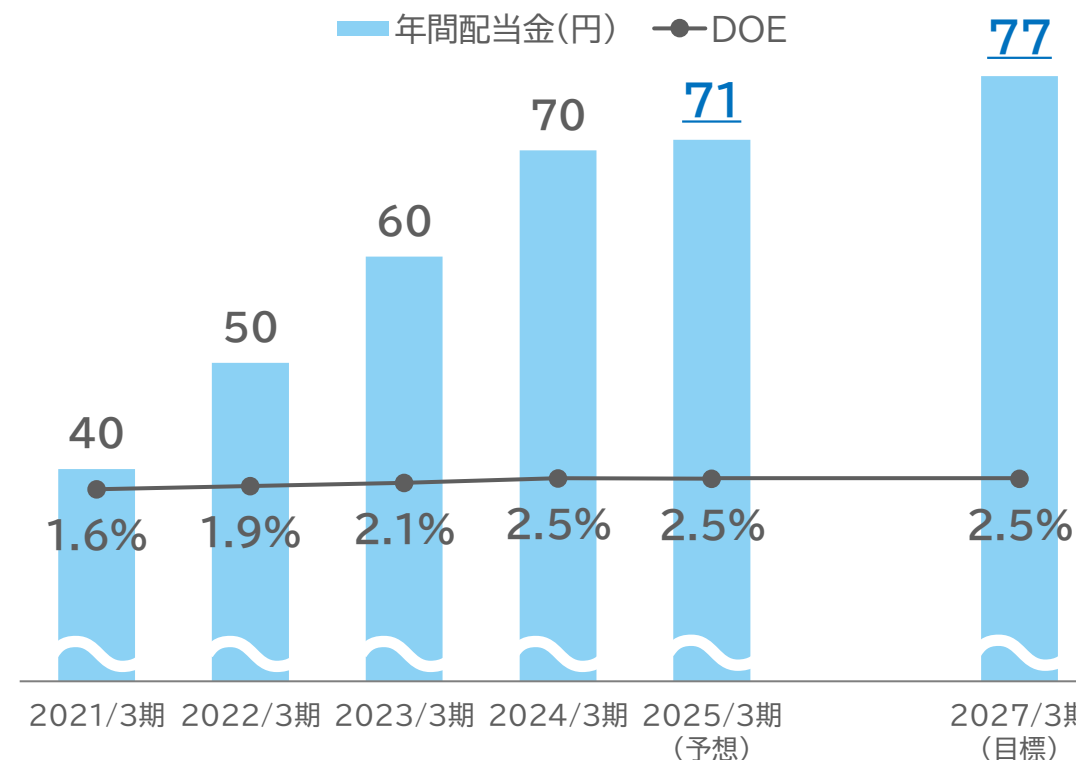


- ・ 2023年5月に配当方針をDOE2.5%以上に変更、2025年3月期は71円(DOE2.5%)への増配を計画

2024年3月期以降の配当方針

- ・ DOE*2.5%以上を配当の数値基準とする
- ・ 中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- ・ 2025年3月期は71円配当を予定(DOE2.5%)

配当金・DOEの推移



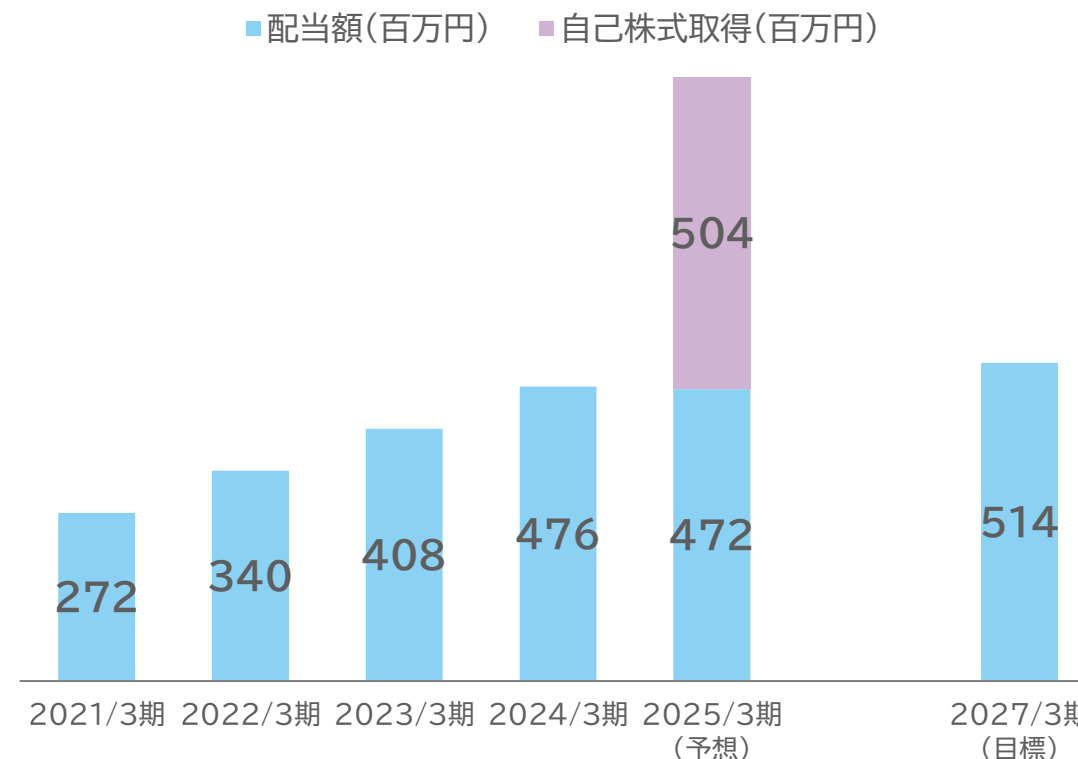
* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

- 機動的な資本政策の実行及び資本効率の向上を通じた株主利益の向上を図るため、自己株式の取得を実施（8月9日公表）
予定の35万株を取得し、12月6日に買付終了

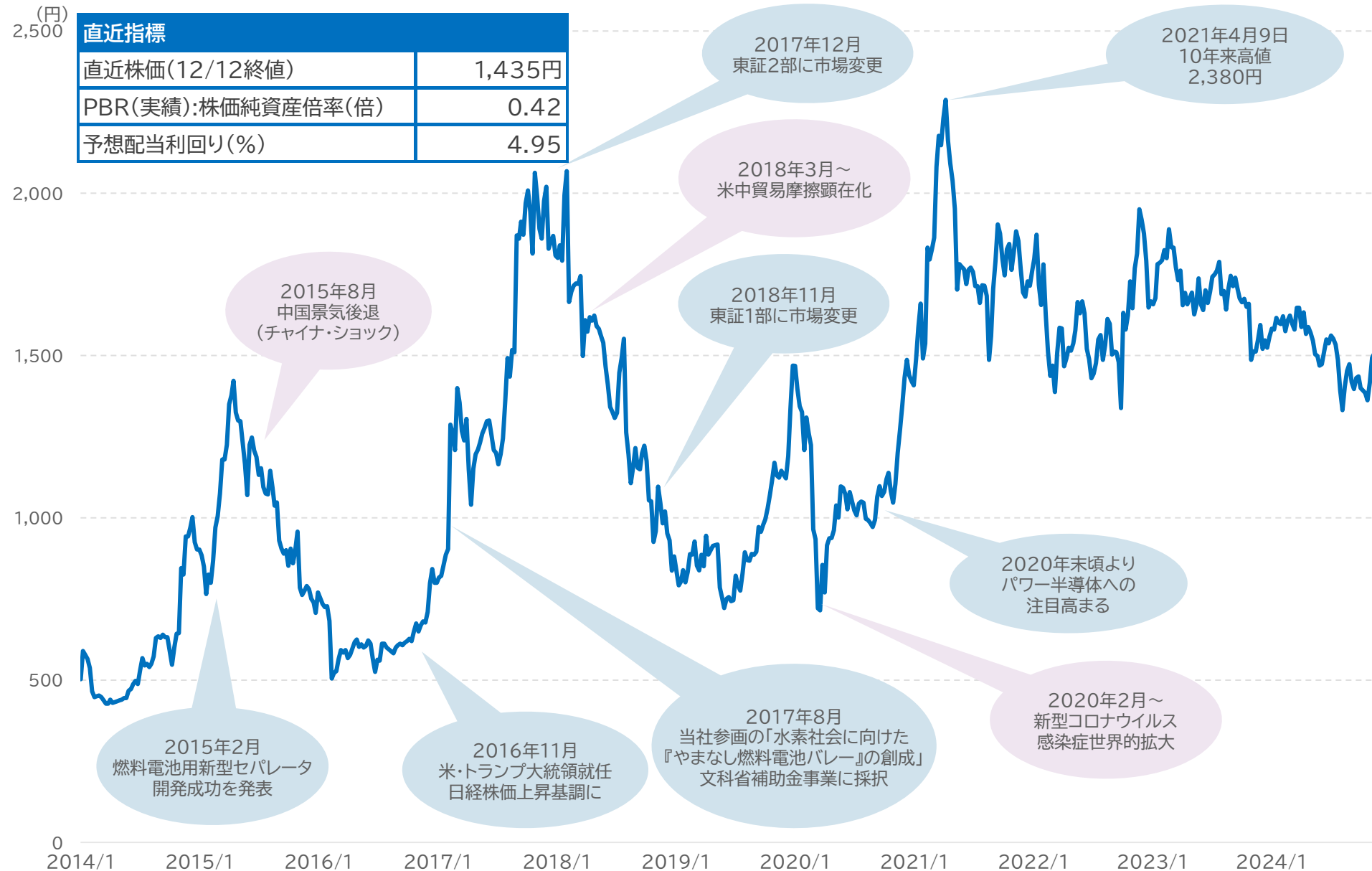
自己株式取得の実施

- 株式の種類：当社普通株式
- 取得株式総数：35万株
- 取得総額：504,793,000円
- 取得期間：2024年8月26日～12月6日

株主還元の推移



* 25/3期の配当額は上限の自己株取得と株式報酬制度による交付が行われたものとして試算



(5) SDGsへの取り組み



- ・ SDGsへの取り組みとして以下を策定し、順調に進捗
- ・ 2022年5月には中期環境計画を定め、2030年のGHG排出削減量を定めて、取り組みを強化
2023年5月には海外工場等も含む連結での中期環境計画を策定
- ・ 2023年11月に「プラチナくるみんプラス*」の認定を取得

重点分野	関連するSDGs	現在の取り組み	今後の取組
脱炭素社会の実現	   	・ 産官学連携による燃料電池部品開発 ・ 太陽光パネルの設置 ・ 照明の完全LED化推進 ・ 中期環境計画の策定と開示	・ 燃料電池部品の量産ライン稼働実験・量産準備 ・ 中期環境計画の各施策実行・進捗の開示 ・ 非化石電力発電所の設置と非化石証書の段階的活用
誰もが活躍できる社会の実現	 	・ 子育てのしやすい環境の整備（プラチナくるみんプラス） ・ 在宅勤務制度の実施 ・ 健康優良企業「銀の認定」 ・ 多様性を重視した管理職育成	・ 制度活用促進によるプラチナくるみんプラスの継続 ・ 多様性を重視した管理職育成 ・ 障がい者・外国籍雇用体制の更なる拡充 ・ 健康優良企業「銀の認定」更新
みんなが幸せになれる社会の実現	   	・ フードバンク活動 ・ 学習支援活動への協賛 ・ 地域活動、スポーツ団体への協賛 ・ ボランティア休暇制度実施	・ ボランティア休暇取得の促進と活動への組織的な参加 ・ 採用活動や経済活動を通じた総合的な地域との共生 ・ 「モノ」「水」「エネルギー」のリサイクル活動強化

*プラチナくるみんプラス：次世代育成支援対策促進法に基づき、「子育て」及び「不妊治療と仕事の両立」支援に取り組んでいる企業を認定

- 単体での中期環境計画に加えて、2023年4月にはグループベースでの中期環境計画を策定

当社グループ全体

2030年度 目標

温室効果ガス(GHG)排出総量 11,080_{t-CO₂}

温室効果ガス(GHG)排出削減量 6,732_{t-CO₂} (2021年度比 38%削減)

アクションプラン

1

再エネ活用

- 太陽光発電設備の設置
- カーボンフリー電力の購入
- EV車両の導入

2

省エネ対策

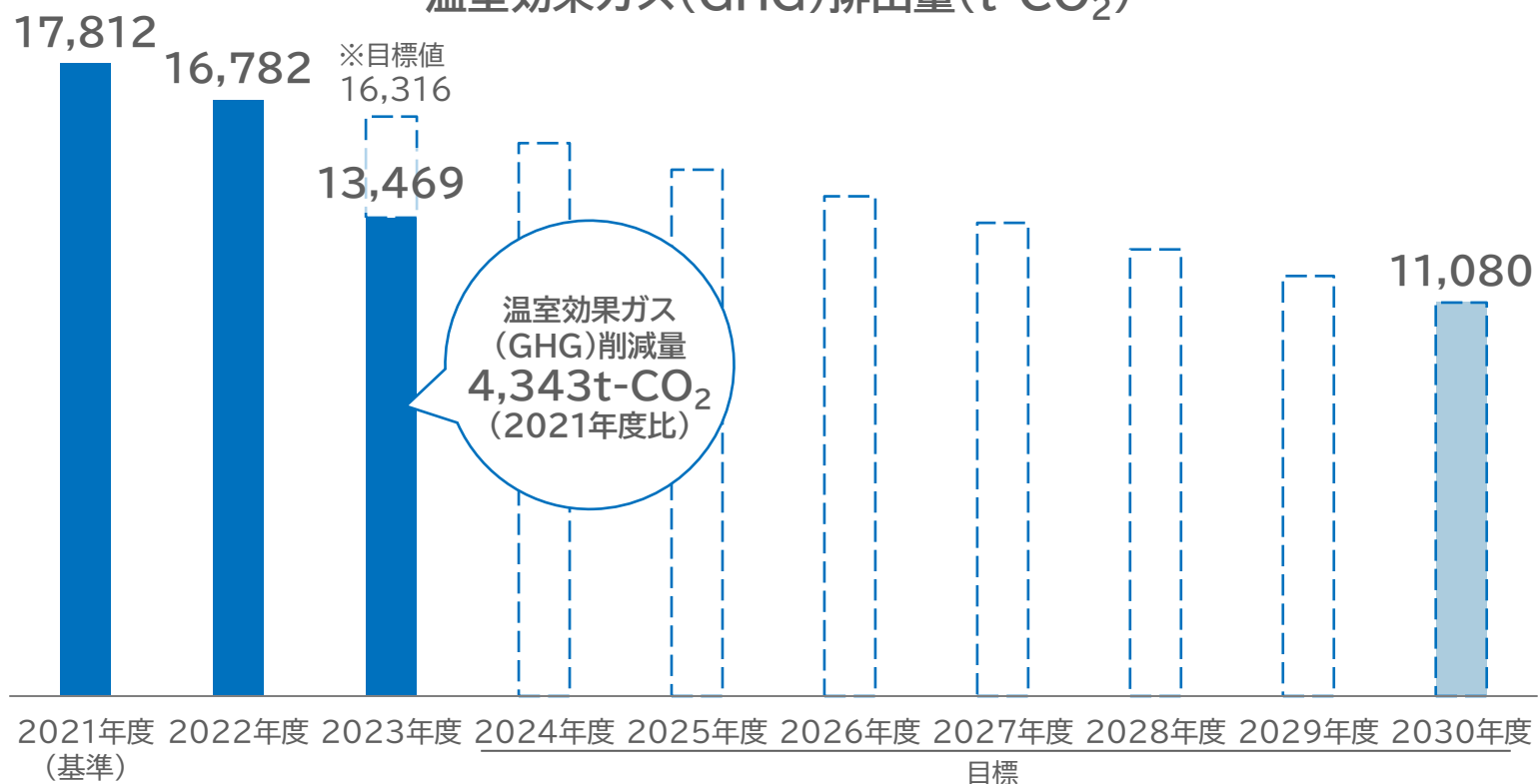
コンプレッサー

空調設備

照明機器

その他、生産設備

温室効果ガス(GHG)排出量(t-CO₂)



2023年度の太陽光発電実績

発電量	3,400千kWh
GHG排出削減量	1,994t-CO ₂

2024度完成予定

◆本社工場(塩山)社員寮跡地

発電容量 : 約250kW

年間発電量 : 約410千kWh(想定)



<効果>

GHG排出削減量

約160t-CO₂

完成後の発電容量

国内 2.6MW

海外 1.6MW

合計 4.2MW

参考情報

本社(上野原)



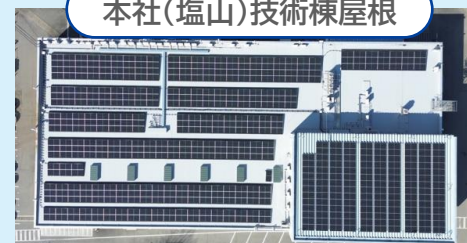
本社(塩山)



本社(塩山)倉庫屋根



本社(塩山)技術棟屋根



津軽



2024年3月 稼働開始

2023年7月 稼働開始

フィリピン

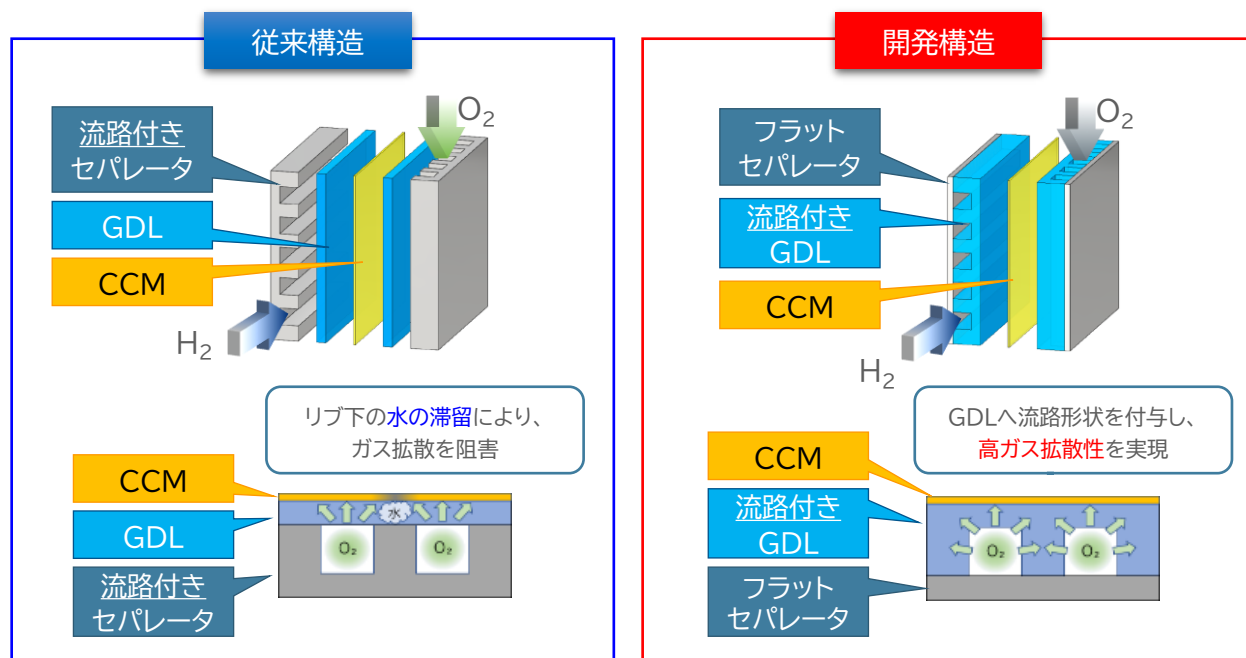


中国



2023年度 増設・稼働

- ・ 固体高分子型燃料電池(PEFC)向けガス拡散層(GDL)一体型金属セパレータを山梨大学と共同開発
- ・ 新開発の流路付きGDL(GDLFC+)で大幅な高電流密度化を実現、当社技術によりGDLにガス流路を成形
- ・ 金属セパレータ、GDLを自社生産し、ガスケットと一体化し、コストを削減
- ・ 2025年に燃料電池車向けのテスト開始、将来は電気自動車、ドローン、緊急電源、エネファーム等での実現を図る



2021年5月

日本で初めて制作された国産の燃料電池を電源とする電動アシスト自転車に当社製「ガス拡散層一体型セパレータ」が搭載

2021年7月

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 共通課題解決型産学官連携研究開発事業に採択
→採択期間は2025年3月まで更新

2022年3月

山梨大学及び大強度陽子加速器施設・J-PARCと 連名で寄稿した論文が『Journal of Power Sources』(ELSEVIER社)にオープンアクセス版として掲載

2023年8月

FCyFINEの水素燃料電池アシスト自転車の実証実験として道の駅 富士川(山梨県南巨摩郡富士川町)にてレンタル自転車を5台導入。

2023年9月

山梨大学及びスズキ株式会社と連名で寄稿した論文**が国際的な学術・技術専門誌「Journal of Power Sources」(ELSEVIER社)オープンアクセス版に掲載。

2023年11月

甲府市役所にて日本で初めて水素燃料電池アシスト自転車を公用自転車として導入し実証実験を開始。

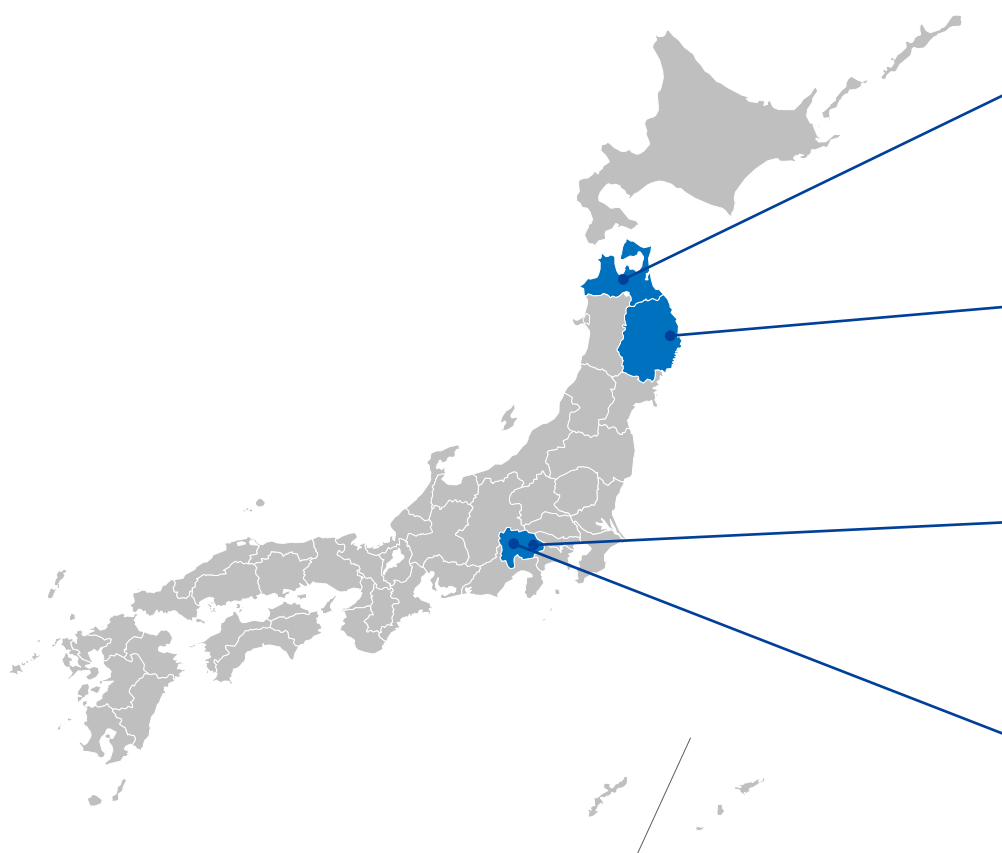
* 「Improvement of PEFC Performance Stability under High and Low Humidification Conditions by Use of a Gas Diffusion Layer with Interdigitated Gas Flow Channels (対向櫛歯型流路が形成されたガス拡散層が固体高分子型燃料電池セルの高加湿および低加湿条件下における出力安定性の向上に及ぼす影響)」
<https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac9edf>

** 「Analysis of performance stability under conditions of high & low humidity of polymer electrolyte fuel cells with interdigitated gas flow channels formed on a gas diffusion layer: An X-ray imaging and modeling study (対向櫛歯状ガス流路を形成させたGDLを有する固体高分子型燃料電池の高湿度・低湿度条件下での性能安定性の解析: X線イメージングとモデリングによる検討)」
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775323009990>

参考資料



- ・ スマートフォンやウェアラブル端末の需要増加に対応するため、津軽工場を増築し、マイクロコネクタの生産能力を増強、5年間の投資額は31億円を計画
- ・ リードフレームはパワー半導体向けなど高電圧・大電流対応品の生産体制を強化



津軽工場

主要生産品目

スマートフォン・ウェアラブル端末向けコネクタ



岩手工場

主要生産品目

車載向け受動部品

スマートフォン向けコネクタ



本社工場(上野原)

主要生産品目

オプト用リードフレーム

リレー部品



本社工場(塩山)

主要生産品目

パワー半導体用リードフレーム

オプト用リードフレーム

- ・ 中山工場(中国)では、リードフレームやコネクタ用部品を、金型製作から組み立てまで一貫生産、パワー半導体向けのクリップボンディングリードフレームを量産
- ・ フィリピン工場では、車載向けのコネクタ用部品などを、金型製作から樹脂成形まで一貫生産、主に日系の東南アジア拠点向けに販売

中国



営業拠点 **ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd**
生産拠点 **ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.**
主要生産品目 パワー半導体用リードフレーム
スマートフォン向けコネクタ用部品

フィリピン



生産拠点 **ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.**
主要生産品目 エアバッグ向け大型コネクタ用部品
車載向けスイッチ部品
パワー半導体用リードフレーム



注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。